



产品规格书/Specification

产品/product:	焊线导电银浆/ Drawing wire silver paste
料号/Part number:	01M-6301

适用范围/Application:

此产品适用电热片、厚膜电路、陶瓷、玻璃等需要引出导线、耐高温的电子器件，可耐 800 度以下高温。
Suitable for drawing wires, can be endure high temperature less than 800°C. .

使用条件/Operating conditions:

基材 Substrate	陶瓷、玻璃等电路、电子器件 Ceramic, ceramic glass etc.
点胶	200-300 目丝网印刷 200-300 mesh stainless screen
流平 Levelling	5-15min minutes at room temperature 室温下流平 5-15 分钟（时间根据流平的实际情况决定）。
干燥 Drying	通风烘箱烘烤 100-150°C，10-15 分钟 （空考温度低于 300°C，可根据烘烤的实际情况决定烘烤时间。） 100-150°C 10-15 min
烧结 Firing Condition	隧道炉空气气氛下烧结，烧结最高温度 500~750°C（推荐值），10 分钟。 Atmospheric firing in belt furnace with peak time of 10 Minutes at 500~750°C
Thinner	ST-1000

性能/Characteristics:

1. 浆料性能/Paste Characteristics:

性能 Characteristic	标准 Standard	测试方法及条件 Test method and conditions
1 Fineness	≤5μm	FOG test
2 Viscosity	200-580Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1°C, Brookfield HBT（博利飞）粘度计， 转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1°C 粘度可根据用户实际需要调节。
3 固体含量	85~95%	

2. 烧结后特性/Characteristics after firing:

在 1 烧结条件下，膜厚 8-12μm Check fired film produced under the conditions specified in 1), (Film thickness is 8-12μm.)



特性 Characteristics	Standard 标准	测试方法和条件 Test method and conditions
3 Resistivity 方阻	$\leq 3\text{m}\Omega/\square$	Test pattern 0.6mm×60mm 测试图形 0.6mm×60mm
4 Adhesion strength 附着力		Peel Test: 0.5mmφ Tin plated Cu wire soldered on 2mm×2mm Pad. 0.5mmφ锡浸铜线，焊接面积 2mm×2mm Solder: 96.5Sn/0.5Cu Mildly activated flux used. 焊料: 96.5Sn/0.5Cu
Initial 初始附着力	$\geq 45.2\text{N}$	
Ageing 老化附着力	$\geq 24.6\text{N}$	Ageing: 150°C×24hrs 老化条件: 150°C, 24 小时

保存条件，有效期/Storage condition and Term of validity

产品应在 5-25°C 的环境温度下密封储存，有效期为产品发货之日起 1 年。

The product shall be guaranteed for 1 year after shipping date, keep tightly under at 5-25°C

包装方式/Packaging method:

标准包装，1000g/罐，样品可提供 200 克小罐包装

Standard package 1000g/can, if you need sample to test, available 200g with small package.

